



Für unser ständig wachsendes Team suchen wir zum baldmöglichen Eintritt einen

Wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w)
- Neue Packaging-Technologie für Mikrosysteme -

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Entwicklung neuer Verfahren für das flexible und zuverlässige Packaging von Mikrosystemen, z.B. Bild- oder Magnetfeldsensor-Chips mit der Film-Assisted-Transfer Molding Technik in Kombination mit Jet-Druck- und Metallbeschichtungsverfahren. Dabei beschäftigen Sie sich im Team mit der gesamten Prozesskette von der Auslegung und Konstruktion des Package über die Fertigung bis hin zur Charakterisierung der Zuverlässigkeit. Nach einer angemessenen Einarbeitungsphase betreuen Sie nationale und internationale Forschungsvorhaben mit namhaften Industrieunternehmen aus Kfz-Technik, Automatisierung, Sensorik und Medizintechnik.

Ihr Profil

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in Mikrosystemtechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Werkstoffkunde oder Physik. Kreativität und Engagement zum Lösen wissenschaftlich-technologischer Fragestellungen gehört ebenso zu Ihren Stärken wie ein hohes Maß an Eigeninitiative. Kommunikationsstärke und die Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten in einem interdisziplinären und internationalen Team runden Ihr Profil ab. Hilfreich aber nicht zwingend erforderlich wären erste Erfahrungen und Kenntnisse aus den Bereichen Aufbau- und Verbindungstechnik, Mikrosystemtechnik oder Sensorik.

Wir bieten Ihnen

eine spannende Tätigkeit in einem ambitionierten Team mit einem attraktiven Arbeitsplatz in einem modernen, bestens ausgestatteten Forschungsinstitut sowie bei entsprechenden Voraussetzungen die Möglichkeit zur begleitenden Promotion. Die Stelle ist zunächst auf 3 Jahre befristet. Die Vergütung orientiert sich an den Rahmenbedingungen für Wissenschaftliche Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes (TV-L).

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühesten Eintrittstermins, gerne auch per Email an unsere Personalabteilung. Für Fragen zur Bewerbung steht Ihnen Frau Bellezer gerne zur Verfügung (Tel. 0711/685-83712). Fachliche Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Buckmüller (Tel. 0711/685-84265; buckmueller@hsg-imat.de).

Zukunftstechnologie
Mikrosystemtechnik

Das Institut für Mikroaufbautechnik der Hahn-Schickard-Gesellschaft (HSG-IMAT) in Stuttgart zählt zu den führenden Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der Aufbau- und Verbindungstechniken (AVT) für Mikrosysteme (MEMS) mit Kunststoffmikrobauteilen und räumlichen elektronischen Baugruppen (MID).

Die Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V. ist Trägerin des Institutes.

HSG-IMAT
Institut für Mikroaufbautechnik

Personalabteilung
Allmandring 9b, 70569 Stuttgart
Tel.: +49 711/685-83712
Fax: +49 711/685-83705
E-Mail: bellezer@hsg-imat.de